

富士通インターコネクトテクノロジーズ(株)アポイントお申込・お問合せはこちら >> 

出展展示会: プリント配線板 EXPO

ブースNo. [20-40]

連絡先

〒: 2118588

住所: 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1東1-210

部署: ビジネス支援グループ 事業管理部

担当者: 小林 秀樹

Tel: 044-754-2260/ Fax: 044-754-2796

E-mail: kobayashi.hideki@fict.fujitsu.com

出展製品 メーカー名**特徴**

シミュレーション・実装設計

DDR2メモリ/Fなど幅広く高速伝送に対応

高密度高多層/ビルドアップ基板

設計～製造まで一貫したサービスを提供

半導体パッケージ用基板

多ピン・ハイエンド向けから薄型モジュールまで

出展製品分類

リジッドプリント配線板

多層プリント配線板

ビルドアッププリント配線板

半導体パッケージ基板

製造・生産受託

設計受託

出展製品のみどころ

半導体パッケージ/モジュール用基板から高多層高速伝送基板/高密度ビルドアップ基板を、実装設計～製造まで一貫したサービスで提供致します。特に、高速動作信頼性を実現するための実装設計+シミュレーション手法を、話題のDDR2メモリ/F適用事例を用いた実波形との比較デモで紹介致します。是非、弊社のブースにお立ち寄り戴き、基板の実装設計から製造迄の一貫したサービスで当社のご利用をご検討下さい。

印刷する

閉じる